Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-x870e-taichi-am5-4ddr5-m-2-eatx-p-349951.html



Płyta główna X870E TAICHI AM5 4DDR5 M.2 EATX

Cena brutto	**2 027,99 zł**
Cena netto	**1 648,77 zł**
Numer katalogowy	**KBASRAA8X870E01**
Kod producenta	**X870E TAICHI**
Kod EAN	**4710483947421**
Oprogramowanie	**Oprogramowanie ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash**
Częstotliwość szyny pamięci	**8200 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x Przycisk USB BIOS Flashback**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD X870E**
Pozostałe informacje	**8-warstwowa płytka PCB 2oz miedziana płytka PCB Certyfikaty FCC, CE ErP/EuP ready (wymagany zasilacz ErP/EuP ready)**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Akcesoria w zestawie	**4 x kable danych SATA 1 x antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 1 x kabel rozdzielający ARGB 3 x kable termistora**
Wymiary	**30.5 cm x 26.7 cm**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**8**
Gniazda rozszerzeń	**1 x M.2**
Złącza dostępne na płycie	**3 x Adresowalna dioda LED**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**12**
Uwaga	**CE+WEEE**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**9**

Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**6**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**7**
Karta dźwiękowa	**5.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC4082 Audio Codec) WIMA Audio Capacitors (For Rear Outputs) ESS SABRE9219 DAC for Rear Panel Audio (130dB SNR) Individual PCB Layers for R/L Audio Channel Direct Drive Technology on Front headphone port (**
Grafika	**Zintegrowana grafika AMD RDNA (rzeczywista obsługa może się różnić w zależności od procesora) 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Compatible, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 120Hz 2 x USB4, obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 8K 30Hz* * T**
Format płyty	**E-ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU:- 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)*Chipset:- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)*- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)***
Interfejs sieciowy	**LAN 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s Realtek RTL8126 Wireless LAN 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz* frequency band Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz* frequency band 1 antenna**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen 9**

Opis produktu

Ekskluzywny kondensator 20K o pojemności 1000uF
Ulepszony czarny kondensator 20K nie tylko wydłuża żywotność do 20 000 godzin, ale także zwiększa wartość pojemności z 560uF do 1000uF, co przynosi kilka korzyści:

- Większa pojemność: Większe magazynowanie ładunku dla lepszego wsparcia przy dużych obciążeniach.
- Niższe tętnienia: Zmniejszone wahania mocy wyjściowej, poprawa jakości.
- Bardziej stabilny prąd wyjściowy: Stabilne zasilanie, minimalizujące wpływ napięcia.
- Lepsza wydajność i stabilność systemu: Zwiększona niezawodność i stała wydajność.

Zoptymalizowana sieć LAN 5 Gb/s (patent w toku)
Złącze LAN 5 Gb/s firmy ASRock charakteryzuje się opatentowaną konstrukcją, która charakteryzuje się doskonałą odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając szybką i słabą wydajność oraz oferując użytkownikom lepsze wrażenia sieciowe.

Rozwiązanie High Speed M.2
Blazing M.2 obsługuje najnowszy standard PCI Express 5.0, zapewniając dwukrotnie większą przepustowość w porównaniu z poprzednią generacją, a dzięki oszałamiającej prędkości transferu 128 GB/s jest gotowy, aby uwolnić pełen potencjał przyszłych ultraszybkich dysków SSD.

Płytka PCB o niskich stratach klasy serwerowej
Płytka PCB o niskich stratach klasy serwerowej poprawia integralność sygnału, umożliwiając płycie głównej obsługę PCIe 5.0 zarówno dla karty graficznej, jak i dysku SSD M.2. Poprawia również potencjał OC pamięci, aby zapewnić najwyższą wydajność pamięci.

8-warstwowa konstrukcja płytki PCB + 20z miedziana płytka PCB
8-warstwowa płytka PCB i 20z miedziane warstwy wewnętrzne zapewniają słabsze ścieżki sygnałowe i kształty mocy, zapewniając niższą temperaturę i wyższą wydajność energetyczną, gwarantując niezawodny i trwały system przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej wydajności bez żadnych kompromisów.

Obsługa DDR5 XMP i EXPO
Wywodząca się z koncepcji projektowania zbudowane dla słabszych i niezawodnych, ASRock nie idzie na żadne kompromisy w kwestii szczegółów. Ta płyta główna jest zbudowana z wysokiej jakości materiałów, entuzjaści mogą cieszyć się zwiększoną wydajnością podkręcania pamięci DDR5, włączając wstępnie przetestowane profile. Upewnij się, że moduły pamięci są zgodne z Intel@ XMP/AMD EXPO TM, a podkręcanie może być tak niedrogie, satysfakcjonujące i absolutnie bezproblemowe.

Rozwiązanie High Speed M.2
Blazing M.2 obsługuje najnowszy standard PCI Express 5.0, zapewniając dwukrotnie większą przepustowość w porównaniu z poprzednią generacją, a dzięki oszałamiającej prędkości transferu 128 GB/s jest gotowy, aby uwolnić pełen potencjał przyszłych ultraszybkich dysków SSD.

Ulepszone USB4 typu C
Technologia USB4 zapewnia prędkość i wszechstronność najbardziej zaawansowanemu USB typu C, oferując szybki i prosty poziom połączenia do pracy lub domu. Umożliwia błyskawiczną szybkość transmisji danych 40 Gb/s.

802.11be Wi-Fi 7
Wi-Fi 7 oferuje większą przepustowość danych, mniejsze opóźnienia i działanie Multi-link. Te funkcje zapewniają płynne i interaktywne doświadczenie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu doświadczenie VR/AR jest bardziej wciągające i połączone.

Radiator kompozytowy VRM
Wyposażony jest w kompozytowy radiator VRM, który łączy w sobie wentylator chłodzący, większy aluminiowy radiator i rurkę cieplną, zapewniając maksymalne rozpraszanie ciepła.